证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-044
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月4日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知》;2020年6月9日,公司第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开。会议应参会董事5名,实际参会董事5名,公司监事列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项通过了以下决议:

一、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展情况,公司对本次非公开发行预案中的相关内容进行了修订,并形成了《惠州中京电子科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司与杨林先生签署附生效条件的(股份认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,公司与杨林先生签署了附生效条件的《惠州中京电子科技股份有限公司与杨林关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展,公司对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》

根据公司将实施的2019年年度权益分派方案、《惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2018年第四次临时股东大会的授权,2018年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由8.98元/股调整为8.88元/股,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《惠州中京电子科技股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告》。

关联董事刘德威先生、余祥斌先生回避表决。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2020年6月9日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-045
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月4日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知》;2020年6月9日,公司第四届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项通过了以下决议:

一、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展情况,公司对本次非公开发行预案中的相关内容进行了修订,并形成了《惠州中京电子科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司与杨林先生签署附生效条件的(股份认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,公司与杨林先生签署了附生效条件的《惠州中京电子科技股份有限公司与杨林关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》。

关联董事杨林先生回避表决。

公司独立董事对该项关联交易进行了事前审阅,同意将其提交公司董事会审议,并就本议案相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展,公司修订并形成了《惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》

根据公司将实施的2019年年度权益分派方案,根据《惠州中京电子科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2018年第四次临时股东大会的授权,2018年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由8.98元/股调整为8.88元/股。

监事会认为,本次调整2018年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,调整程序合法、有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
监事会
2020年6月9日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-046
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“中京电子”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200909号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。

根据《反馈意见通知书》的相关要求,公司本次非公开发行股票的认购对象实际控制人杨林先生,以及控股股东惠州市京港投资发展有限公司出具了《惠州中京电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于不减持公司股份的承诺函》,具体内容如下:

“1、本公司/本人及本公司/本人的关联方在本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月不出售或以任何方式减持已持有的发行人的股份,亦不存在任何减持计划。

2、本公司/本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情形;

3、本公司/本人承诺上述内容的真实、准确与完整,如本公司/本人违反上述承诺而发生减持情况,本公司/本人承诺因减持所得收益全部归发行人所有,并依法承担由此产生的法律责任。”

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2020年6月9日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-047
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、关联交易概述

2020年3月6日,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中京电子”)召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与杨林先生签署附生效条件的(股份认购协议)的议案》等议案,确认本次非公开发行的发行对象为包括杨林先生在内的不超过35名的特定对象,并同意公司与杨林先生签署附生效条件的《关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。

2020年6月9日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与杨林先生签署附生效条件的(股份认购协议之补充协议)的议案》、《关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等议案,根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,公司与杨林先生签署附生效条件的《关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》(以下简称“《股份认购协议之补充协议》”)。

杨林先生为公司实际控制人、董事长,因此杨林先生与公司签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》构成关联交易。

公司董事会在审议《股份认购协议之补充协议》事项时,关联董事已对相关议案回避表决。

二、《股份认购协议之补充协议》的主要内容

(一)协议主体、签订时间

2020年6月9日,公司与杨林先生签署《关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》。

(二)认购股份数量

1、本次发行中认购人(杨林先生)认购本次发行总金额为不低于伍仟万元整(小写:50,000,000元)且不高于壹亿元整(小写:100,000,000元),最终认购金额由双方在本次发行前协商确定,认购股份数量为认购款总金额除以实际发行价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

2、若本次发行出现无人报价情形或未能通过竞价方式产生发行价格,认购人(杨林先生)承诺以发行底价(定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%)作为认购价格参与本次认购,认购金额不低于伍仟万元整(小写:50,000,000元)且不高于壹亿元整(小写:100,000,000元),最终认购金额由双方在本次发行前协商确定,认购股份数量为认购款总金额除以发行底价,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

(三)其他

《股份认购协议之补充协议》是在《股份认购协议》的基础上签署,《股份认购协议之补充协议》与《股份认购协议》具有同等的法律效力,是《股份认购协议》不可分割的组成部分。《股份认购协议之补充协议》与《股份认购协议》内容不一致处,以《股份认购协议之补充协议》为准;《股份认购协议之补充协议》未约定的,以《股份认购协议》的约定为准。

《股份认购协议之补充协议》自认购人(杨林先生)签字及中京电子法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,在《股份认购协议》生效时《股份认购协议之补充协议》同时生效

三、本次交易对公司的影响

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,公司与实际控制人杨林先生签署《股份认购协议补充协议》,协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规及规范性文件的规定,相关条款的约定均立足于正常的商业原则,公平、公正、合理,不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变化,不会导致公司股东结构发生重大变化。

四、过去12个月内交易对方和公司之间已发生的关联交易情况

截至本公告披露日,过去12个月内杨林先生与公司之间不存在除本次发行以外的其他关联交易。

五、本次交易履行的审议程序

(一)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对于《股份认购协议之补充协议》发表了事前认可意见,并发表独立意见如下:

“公司与本次非公开发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议之补充协议》,均系双方真实意思表示,协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规及规范性文件的规定。关联董事在董事会审议相关议事时已回避表决,表决程序符合相关规定。我们同意公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。”

(二)董事会审议情况

2020年6月9日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司与杨林先生签署附生效条件的(股份认购协议之补充协议)的议案》等议案,关联董事已回避表决。

(三)监事会审议情况

2020年6月9日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于公司与杨林先生签署附生效条件的(股份认购协议之补充协议)的议案》等议案。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见;

4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见;

5、公司与杨林先生签署的《关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2020年6月9日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-048
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3月6日召开第四届董事会第十二次会议、于2020年3月25日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票预案以及相关议案。

2020年6月9日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,对本次非公开发行股票预案进行了修订,主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序,尚待履行审批程序;明确杨林先生认购上限、在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格情形下的认购安排
释义	释义	修订、补充相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司的基本情况	更新公司注册资本情况
	三、本次发行方案概要	明确杨林先生认购上限、在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格情形下的认购安排
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司总股本、本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股比例变化情况
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	明确杨林先生认购上限
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	二、《股份认购协议之补充协议》	补充《股份认购协议之补充协议》主要条款
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	更新本次募投项目备案、环评相关情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	更新公司总股本、本次发行前后公司控股股东及实际控制人持股比例变化情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关的风险说明
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司2016-2018年三年利润分配情况	补充2019年度利润分配方案情况
第七节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据2019年年度报告数据,更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的中小板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)的《惠州中京电子科技股份有限公司2020年度非公开发行股A股股票预案(修订稿)》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2020年6月9日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2020-049
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设和前提

本次非公开发行实施完成后,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果未来公司业务未获得相应幅度的增长,公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。

考虑上述情况,公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算,以下假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设如下:

1、假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化;

2、为最大限度考虑摊薄即期回报对财务指标的影响,假设本次非公开发行于2020年9月底实施完毕,该完成时间仅为测算的假设时间,最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行完成时间为准;

3、为量化分析本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响,假设本次非公开发行数量为118,000,000股,募集资金总额为120,000万元,同时,本次测算不考虑发行费用的影响,最终发行数量和募集资金总额以经中国证监会核准的情况为准;

4、根据公司2019年年度报告,2019年末归属于公司股东的净资产为134,044.01万元,2019年度归属于公司股东的净利润为14,869.05万元,2019年度扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为11,936.14万元;

5、假设2020年归属于公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别有以下三种情况:(1)与2019年度持平;(2)较2019年度增长10%;(3)较2019年度增长20%;

6、在预测公司发行后总股本时,以2019年末公司总股本396,158,821股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、期权激励行权、股票回购注销等)对本公司股本总额的影响。

(二)本次发行对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2019年度/2019.12.31	2020年度/2020.12.31	
		发行前	发行后
总股本(股)	396,158,821	396,158,821	514,158,821
假设情形(1):2020年净利润年较2019年度保持不变			
归属于公司股东的净资产(万元)	134,044.01	148,913.06	268,913.06
归属于公司股东的净利润(万元)	14,869.05	14,869.05	14,869.05
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润(万元)	11,936.14	11,936.14	11,936.14
基本每股收益(元/股)	0.40	0.38	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.38	0.35
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.32	0.30	0.28
加权平均净资产收益率	13.58%	10.51%	8.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.90%	8.44%	6.96%
假设情形(2):2020年净利润年较2019年度增长10%			
归属于公司股东的净资产(万元)	134,044.01	150,399.97	270,399.97
归属于公司股东的净利润(万元)	14,869.05	16,355.96	16,355.96
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润(万元)	11,936.14	13,129.75	13,129.75
基本每股收益(元/股)	0.40	0.41	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.33	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.41	0.38
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.32	0.33	0.31
加权平均净资产收益率	13.58%	11.50%	9.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.90%	9.23%	7.62%
假设情形(3):2020年净利润年较2019年度增长20%			
归属于公司股东的净资产(万元)	134,044.01	151,886.87	271,886.87
归属于公司股东的净利润(万元)	14,869.05	17,842.86	17,842.86
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润(万元)	11,936.14	14,323.37	14,323.37
基本每股收益(元/股)	0.40	0.45	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.36	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.45	0.42
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.32	0.36	0.34
加权平均净资产收益率	13.58%	12.48%	10.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.90%	10.02%	8.28%

注:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算

通过上述测算,不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营业绩、财务状况的影响,本次非公开发行完成后,公司的每股收益、加权平均净资产收益率可能下降,公司面临即期回报被摊薄的风险。

二、对本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,募集资金将显著的增加公司股东权益,但募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期,募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放,股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司的每股收益被摊薄。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性与合理性

(一)本次非公开发行募集资金投资项目建设的必要性

1、紧抓5G通信等下游新兴应用领域的发展机遇,提升核心产品竞争力和公司市场地位

近年来,电子信息产业蓬勃发展、技术升级层出不穷,从而对PCB产品的工艺标准、技术参数、产品品质等各方面提出了新的要求。在通信代际更迭、数据流量爆发式增长的背景下,5G通信网络的建设及5G产品的应用已成为PCB行业发展的催化剂,也势必带动对5G通信基站与基站天线、高性能服务器、5G网络交换机、路由器、光传送网等通信设备和5G智能终端产品的高速增长。同时,随着5G通信在高清显示、云计算、人工智能、无人驾驶、物联网等应用领域的商用进程加快,催生的通信、计算和存储需求也会越来越旺盛。

以5G通信为例,5G的高频高速、高性能、低延迟与高容量特性,将带动5G终端产品朝着高频高速、高度集成、轻薄化、智能化发展,从而使得PCB的孔径越来越小,纵横比越来越大,阻抗控制要求越来越严,布线密度越来越高,背钻孔间走线等节省空间的设计越来越多,对低损耗及高频高速材料的应用越来越广泛,对高速高多层PCB、高阶高密度互联板(HDI & Any Layers HDI)以及对三维封装及空间节省要求较高的刚柔结合板(R-F)、类载板(SLP)等工艺产品的需求将大幅提升。

目前,受制于原有场地设计、产能等限制,公司多层板产品的平均层数仍受到一定限制,HDI以及刚柔结合板的业务比重依然有较大提升空间,公司需进一步加快生产的智能化产线布局、加大在蚀刻、对位层压、钻孔、电镀、蚀刻、阻焊等重点工艺环节的高精密度和更高性能的设备、设施投入,提升产品层阶和生产工艺标准,从而抓住5G等下游新兴应用领域发展机遇。

公司通过实施本次募投项目建设智能制造工厂,采用高精密度生产设备、智能化系统,能够满足5G通信、新型高清显示、汽车电子、人工智能、物联网以及大数据、云计算等新兴应用领域对PCB产品的高层阶和高工艺标准,从而提升公司的核心竞争力和市场地位。

2、扩大产能规模、解决产能瓶颈,实现PCB主业的做大做强

公司现有的产能主要来源于2014年竣工的IPO募投项目以及之前的项目建设。近年来,随着公司PCB主营业务收入的持续快速增长,公司产能利用率已接近饱和:2017年、2018年、2019年公司营业总收入增幅分别达到35.55%、63.61%、19.16%,产能利用率超过90%。虽然公司通过利润滚动投入,持续进行小规模的技术改造、设备升级,但产能的增幅相对有限。随着下游新兴应用领域的蓬勃发展、客户合作的不断深入,客户的单批次订单量不断上升,公司现有的产能将无法持续满足下游客户批量订单的新增需求。

通过实施本次募投项目,有助于进一步扩大公司经营规模,缓解目前产能接近饱和的局面,强化公司与大客户战略粘性,满足公司业务持续发展的需要,实现PCB主业的做大做强。

3、新建智能制造数字化工厂提升自动化、信息化水平,提高生产效率及盈利水平

根据国内外PCB龙头企业的历史发展经验,优化产线布局、提升生产与控制系统的智能化水平,是节约劳动力和物料,提高产品良率,实现高效成本控制和提升生产效率的有效措施。近年来,随着用工成本的提升以及上游原材料价格的波动,PCB制造企业的成本控制、效率提升压力日益紧迫。

公司现有工厂筹建时间较早,虽然近年来通过持续的项目技改、管理改善,公司在成本控制、人工效率、产品毛利方面均有一定幅度的提升,但受制于工厂架构及布局,升级改造空间相对有限。目前,相较于国内较多PCB上市公司在2016年-2019年新建工厂,公司现有工厂在智能化设计、精密化设备的配套、自动化、信息化以及数字化水平等方面存在一定的差距,从而导致公司生产成本相对较高,产品利润率相对偏低。

公司《中京电子基于工业互联网的印制电路板生产过程管控优化》项目已入围2020年惠州市工业互联网标杆示范项目,公司在智能制造、数字化生产等方面已有一定的技术和管理经验积累。公司通过实施本次募投项目建设智能制造数字化工厂,能够进一步有效提高生产效率,从而进一步改善公司的盈利水平,实现公司经营效益的持续稳步提升。

(二)本次非公开发行募集资金投资项目建设的合理性

1、公司具有良好的生产工艺基础和高端制造能力

公司在PCB领域深耕二十年,通过不断的经验积累、技术改进,具有良好的生产工艺基础和高端制造能力。公司系中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长单位,CPCA行业标准制定单位之一,系工信部首批符合《印制电路板行业规范条件》的PCB企业,已通过工信部两化融合管理体系认证,并获得广东省知识产权优势企业、优秀电子电路行业名族品牌企业、惠州市工业互联网标杆示范项目、广东省LED封装印制电路板工程技术研究中心等资质及荣誉称号。

公司产品包括双面板、多层板、高密度互联板(HDI)、柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA),是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。以HDI和刚柔结合板为例:(1)在HDI方面,公司HDI项目(IPO募投项目)自2012年开始投建,2014年投产,产品已实现二阶、三阶大批量生产,并已具备更高阶及Any-layer HDI的批量生产能力,在高阶HDI、精细线路、层间对位控制等关键性技术上达到国内较为领先的水平;(2)在刚柔结合板方面,公司全资子公司元盛电子、中京科技均具备刚柔结合板生产能力,并均已实现批量供货,但均受制于产能而无法承载客户大批量订单,无法实现较好的规模效益。

2、公司具有较强的新产品开发能力和新技术应用能力

公司长期重视并坚持技术创新和新产品开发,在内部设有技术委员会和专家委员会,拥有省级工程研发中心和企业技术中心、国家级博士后科研工作站。公司系广东省创新型企业、国家级火炬计划重点高新技术企业、2019年全国电子信息行业创新企业,截至本预案公告日,已取得20项高新技术产品认定、69项专利。

同时,公司积极借助外部的有利环境,加强与客户在新产品、新技术等方面的合作开发、同步开发,快速响应客户的需求变化,并与电子科技大学、华南理工大学、广东工业大学、华南师范大学等国内著名高校建立了稳定的产学研合作关系,推动新技术、新产品的产业化。

针对本次募投项目所涉及的新产品,公司已经具备较为成熟的技术储备和良好的产品开发能力:(1)在5G通信配套领域,针对高速高频PCB,公司已经完成了相关材料测试,提升了阻抗控制、对准度控制、纵横比制作能力和背钻技术的开发能力,公司已申请5项5G技术相关专利并已获得受理。公司在5G通信设备(光模块、服务器、路由器、Wifi、基站天线等)、5G移动终端的配套PCB产品已处于配套开发、小批量生产阶段,部分产品已向客户批量供货生产;(2)在新型高清显示配套领域,公司系国内LED/Mini LED用PCB领域的龙头企业之一,被认定为广东省LED封装印制电路板工程技术研究中心,参与了《高亮度LED用印制电路板》等多项行业标准的制定,Mini LED显示屏的封装基板关键技术处于国内较为领先的水平,小间距LED用PCB已实现大批量供货。

3、公司丰富的客户资源和较强的市场开拓能力,能够消化募投项目产能

经过长期的拓展和积累,凭借“技术创新、品质至上、用户满意”的经营理念,公司在行业内树立了良好的声誉和品牌形象,并积累了丰富的客户资源。

在5G通信领域,公司在5G通信设备和5G移动终端等方面均储备了丰富的客户资源,目前正积极进行产品开发、测试打样,部分产品已向客户小批量供货生产,其中:(1)在5G光模块、服务器、基站用LCP高频传输线方面,公司已完成样品生产,正进行材料可制造性、可靠性、电性能等方面的测试,即将进入小批量生产阶段;(2)在交换机、WiFi、路由器、5G Mifi等网络通讯设备方面,公司正逐步实现小批量供货;(3)在移动智能终端方面,公司与华勤、闻泰、龙旗等国内主要知名的ODM厂商均保持长期稳定的合作关系,可快速实现产品导入;(4)在智能手机天线、新型显示、摄像头模组等领域,公司与京东方、深天马、顺贝德、信维通信、丘钛科技等保持良好的合作关系。

在新型高清显示领域,公司在小点间距LED配套等细分领域具有较强的竞争优势和客户认可度,在新兴的Mini LED配套领域也已实现了批量供货。目前,公司已与艾比森、洲明科技、国星光电、光祥科技、强力巨彩等多家知名LED厂商保持长期良好的业务合作。

在汽车电子领域,由于汽车电子系公司长期及拟重点发展的细分市场之一,公司已与比亚迪、华阳通用、康明斯等在流媒体、新能源电池管理模块、机电管理系统等应用领域保持良好的业务合作。

4、公司具有良好的经营管理经验,能够有效保证募投项目的成功实施

公司核心管理人员均拥有近20年PCB研发、生产、销售或服务等实务管理经验。近年来,公司坚持“改革、创新、高效”发展与管理思路,重点关注、学习和借鉴国内外先进企业的管理经验,持续提升管理运营效率和盈利能力。

近年来,公司持续开展了多项改革举措:(1)在人力资源方面,公司聘请了专业咨询机构对公司组织机构、职能模块、考核机制,人才的激励和晋升路径进行系统性的梳理和全面优化,公司实施了2016年度限制性股票激励计划和2018年度期权激励计划,并取得了良好激励效果;(2)在生产制造方面,公司持续引进业内高级技术与管理人才,吸收和借鉴行业先进企业的发展经验和方法,积极优化工艺流程,强化成本控制意识,提升生产效率和产品良率;同时引进外部专业机构积极辅导“精益生产”体系,以从各环节提高制造与品质系统的精细管理能力,为降低成本提升制程效益做出了实质性改善;(3)在信息化建设方面,公司全面优化升级OA系统、HR系统、CRM系统、ERP系统,并已开展MES、EAP、APS、WMS等系统的选型与方案设计,以保障珠海募投项目工厂的柔性与数字化制造能力,并积极持续推进公司制程智能化与工业互联网改造项目。

综上所述,公司核心管理人员多年来积累了丰富的经营管理经验,能够有效保障企业生产经营的有序进行以及本次募投项目的成功实施。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于公司优化产品结构和巩固市场地位,对公司扩大产能、丰富公司业务结构及产品品种、寻求新的利润增长点、提升持续盈利能力具有重要意义。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备情况

在人员和技术方面,公司历来重视人才培养和储备,经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。管理人员之间分工明确,对公司未来发展拥有共同理念,并形成了团结、高效、务实的经营管理风格。在日常生产经营中,公司核心管理团队注重质量控制和成本管理,确保产品的市场竞争力,不断开拓市场,有效提升了公司的市场知名度。同时,公司拥有一支业务能力强、专业程度高的研发队伍,技术骨干均长期从事印制电路板领域相关生产技术的研究、开发工作,在印制电路板领域具备丰富的经验。

2、技术储备情况

公司自成立以来坚持以科技创新为导向,依靠科技进步保持持续发展,公司十分重视研发投入。公司拥有多项专利与非专利技术,技术研发实力雄厚。同时公司通过不断引进先进的研发、生产和检测设备,提高研发生产能力,保证了公司在行业内的研发生产优势。公司在研发方面的基础和实力保证了公司在技术与研发上的领先优势,积累了丰富的研发经验和成功研发案例,为本此募投项目的顺利开展奠定了良好的基础。

3、市场储备情况

公司通过多年的经营发展,打造了一支专业、稳定的营销队伍,形成了一套基于客户需求并适应于公司产品与技术特点的营销体系。近年来,公司积极开拓行业细分市场龙头客户,向大品牌、大应用集中,打造优质客户群,并获得华为二级供应商资质,凭借较强的研发创新能力和技术实力,公司产品质量和性能处于行业领先地位。近年来陆续通过客户的产品认证程序,与下游厂商建立了长期稳定的战略合作关系,积累了大量优质的客户资源。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过提升公司内部管理,不断完善公司治理等措施,提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补即期回报。具体措施如下:

(一)加快募投项目实施进度以实现预期效益

公司本次非公开发行募集资金主要用于珠海富山高密度印制电路板(PCB)建设项目(1-A期),符合国家产业政策和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。该项目的建成将有助于进一步扩大公司业务规模,丰富公司产品结构,促进公司产品升级,满足客户在5G通信、新型高清显示、汽车电子、人工智能、物联网以及大数据、云计算等新兴应用领域快速增长的产品需求,持续提升公司竞争力。随着项目逐步实施将对公司经营业绩带来显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。为此,